



IV/09

LACH DIAMANT „CBN-DUO-power“ mit chipbreaker noch wirtschaftlicher

Die vom Diamant- und CBN-Werkzeughersteller LACH DIAMANT gefertigten CBN-Wendeschneidplatten „CBN-DUO-power“ für das Fertigdrehen gehärteter Stähle und Grauguss sind in der Ausführung mit dem Spanbrecher – dem so genannten chipbreaker – jetzt noch wirtschaftlicher einsetzbar. „Erfreulich für den Anwender“, so Horst Lach, Geschäftsführer der LACH DIAMANT, Jakob Lach GmbH & Co. KG, Hanau. „Dank gesteigerter Fertigung und Robot-Technik wurden ab 1.10.2009 für CBN-DUO-power-Schneidplatten mit chipbreaker die Preise gesenkt.“ Die beim Drehen hochlegierter gehärteter Stähle, Werkzeug- und Einsatzstähle und bei der Zerspanung von Bauteilen aus Grauguss erreichte „power-Leistung“ wird durch die doppelte Schneidenbestückung – das „DUO“ – quasi verdoppelt. „CBN-DUO-power“ wird geprägt von den langzeiterprobten CBN-Sorten B600 und B610 (LACH-Norm). In der Ausführung mit chipbreaker des Typs CO (Europa-Patent Nr. 1023961) offenbart die „CBN-DUO-power“-Wendeschneidplatte ihre Leistungsfähigkeit unübertroffen beim Drehen bei gefördertem gratfreien Schnitt an zum Beispiel dünnwandigen besonders labilen Bauteilen – auch bei unterschiedlicher Härte.

weitere Infos www.lach-diamant.de

Neuheiten von LACH DIAMANT auf der productronica

Hanauer Ideen-Schmiede entwickelt Diamant-Werkzeuge für die Elektronikindustrie

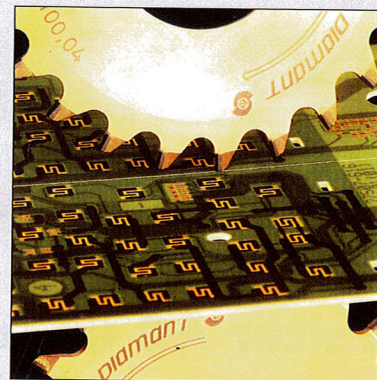
Vom 10.–13. November 2009 präsentiert die LACH DIAMANT Jakob Lach GmbH & Co. KG auf der productronica in München neue Diamant-Werkzeuge, die von dem Hanauer Unternehmen speziell für die Elektronikindustrie entwickelt werden.

Die alle zwei Jahre stattfindende Weltleitmesse für innovative Elektronikfertigung productronica bildet das gesamte Spektrum aktueller und zukunftsweisender Produkte, Technologien und Systemlösungen lückenlos in Breite und Tiefe über die gesamte Wertschöpfungskette ab. Bereits auf der ersten productronica 1977 hatten Diamant-Werkzeuge für die Herstellung von Leiterplatten aus dem Hause LACH DIAMANT Premiere. Heute gehören diese Werkzeuge zur Bearbeitung von glasfaserver-

stärkten Materialien längst zum Stand der Technik und haben erfolgreich zur Miniaturisierung in der Elektronik-Industrie beigetragen.

In diesem Jahr stellt LACH DIAMANT in der Halle B2, Stand 126, Neuheiten wie Diamant-Sägeblätter als Nutzentrenner für das Trennen von Aluminium-Leiterplatten sowie Kombi-Diamant-Werkzeuge für Multilayer vor. Darüber hinaus wird das gesamte LACH-Programm der Diamant- und Hartmetall-Werkzeuge für das Fräsen, Trennen und Ritzen von Leiterplattenmaterialien (PCB und Aluminium) präsentiert.

LACH-DIAMANT bietet als Pionier in der Entwicklung von Diamant-Werkzeugen heute seinen nationalen und internationalen Partnern ein Spitzen-Know-how



Diamant-Sägeblätter von LACH als Nutzentrenner für das Trennen von Aluminium-Leiterplatten

für die Bearbeitung von Leiterplattenmaterialien mit eigenen Diamant-Schärfdiensten in Deutschland und den USA.

weitere Infos www.lach-diamant.de